

Brennendes Thema: Multiple Solder Limits

Derzeit sorgen Diskussionen über mögliche neue Vorgaben für die Zulassungen der US-Organisation Underwriters Laboratories (UL) für Unruhe in der Branche: Bis dato war es so, dass nahezu alle UL-Zertifizierungen mit *einem* Solder Limit hinterlegt wurden, das repräsentativ für die Bestückung von Baugruppen angewandt wurde. Elektronische Baugruppen werden jedoch abhängig von verschiedenen Faktoren und Anwendungen nicht nur mit einem, sondern sehr häufig mit mehreren Lötzyklen verarbeitet. Hier setzt UL an und will jetzt entsprechend differenzierte Vorgaben umgesetzt haben. Damit werden nahezu alle erteilten UL-Zertifizierungen in Frage gestellt. Schlimmstenfalls könnten sie sogar nach einer von UL ins Gespräch gebrachten Übergangsfrist von zwei Jahren komplett außer Kraft gesetzt werden.

Seit Ende 2017 hat UL zu diesem Thema Vorträge auf verschiedenen Veranstaltungen und Kongressen gehalten, gleichzeitig aber bis heute kein offizielles Statement dazu abgegeben. Dies hat außerdem zu einer überaus unklaren Informationslage geführt.

Vertreter des österreichischen Leiterplattenherstellers AT&S und des Fachverbandes Elektronik-Design e. V. (FED) haben im Juni mit UL dieses Thema im Detail besprochen und analysiert. Sie haben in diesem Gespräch, das bei AT&S stattfand, zunächst generell

ein erstes offizielles Veto bei UL eingelegt – gegen die Art und Weise der Bekanntmachungen und gegen die fehlende offizielle Veröffentlichung durch UL.

Mit dem Ziel, einem geordneten Ablauf in der Etablierung der neuen UL-Regeln zu erarbeiten, müs-

sen alle Beteiligten in der Branche zum Thema Multiple Solder Limits intensiv zusammenarbeiten und einen Aktionsplan zur weiteren Vorgehensweise aufstellen. Ich bin überzeugt, dass dieses Thema nur in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit der beiden Verbände FED und dem ZVEI und unter Mitarbeit der Basismaterial-, Lack-, Leiterplatten- und Baugruppenhersteller gestemmt werden kann.

Eine von FED und ZVEI ins Leben gerufene Initiative wird hierzu im August tagen. Außerdem wurde im

Standard Technical Panel (STP) – das ist das Gremium in den USA, das die UL Standards ausarbeitet und festlegt – ebenfalls eine Taskforce zum Thema Multiple Solder Limits gestartet. AT&S ist zur Zeit der einzige europäische Hersteller mit einer Stimme in diesem Gremium und wird versuchen, die in der Initiative von FED und ZVEI erarbeiteten standardisierten Multiple Solder Limits im STP einzubringen.



Jürgen Deutschmann

Stellv. Vorsitzender des FED-Beirates, Supplier Quality Manager & UL Coordinator, AT&S Austrian Technology & Systemtechnik AG